

今天是：2018年10月16日 星期二

请输入关键字

[首页](#) | [机构概况](#) | [科研成果](#) | [研究队伍](#) | [国际交流](#) | [院地合作](#) | [研究生教育](#) | [创新文化](#) | [党群园地](#) | [科学传播](#) | [信息公开](#)**新闻动态**

- 综合新闻
- 图片新闻
- 科研动态
- 学术活动
- 媒体报道

您现在的位置：首页 &gt; 新闻动态 &gt; 综合新闻

## 声学所为射频器件封装研发提供最新封装方法和资料

2017/05/22 | 作者：超声技术中心 | 【大 中 小】 [\[打印\]](#) [\[关闭\]](#)

近日，中国科学院声学研究所超声技术中心研究员李红浪参与研究编著的图书《RF Microwave Microelectronics Packaging II》（中文译名为《射频微波微电子封装II》）已经由Springer出版社推出出版。

随着射频器件的快速发展，电子器件的封装成为一个重要且核心的技术问题。和器件芯片制造同样重要，封装中需要考虑热、电、机械等因素决定了器件的性能。该书首先介绍了射频微波器件与射频发射和接收模组封装发展，然后给出了三维芯片连接方式、射频微波器件电磁屏蔽方法、射频器件的低温陶瓷共烧技术、芯片级射频MEMS器件封装技术、功放封装与组装技术以及高温热电导材料和纳米管材料等。该书为射频器件封装研究和设计研究人员提供了最新的封装方法和资料。



Copyright 2003-2016 中国科学院声学所 版权所有 备案序号：[京ICP备16057196号](#) 京公网安备110402500001号  
地址：北京市海淀区北四环西路21号中国科学院声学研究所 邮编：100190  
E-mail：[ioa@mail.ioa.ac.cn](mailto:ioa@mail.ioa.ac.cn)

